

Sumitomo 银胶 T-3007-20

For LED Lamp(发光二极管)

基本技术资料:

FILLER TYPE: SILVER	填充剂	银 (含量: 78-82%)
Viscosity@20°C	粘度	15,000~25,000cps
/	比重	3.6±0.2
Recommended Cure Condition	建议热化方式	90 分钟/150°C
/	接着强度	1.5mm×1.5mm Si chip 在 150°C 90 分钟
Glass Transition Temperature (Tg)	玻璃转换温度	120~140°C
Coefficient of Thermal Expansion(TMA)	温度膨胀系数	Below Tg: $9 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ Above Tg: $5 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$
Thermal Conductivity @ 121°C	热传导性	1.2 W/ m°C
/	包装	200gms/罐
Storage Life @ -15°C	储存期限	6 个月

银胶使用方法:

1. 退温约: 120-180 分钟 (常温条件之下)
2. 徐徐搅拌约15分钟, 搅拌方向顺时针, 速度不能太快, 避免加速硬化. 请勿用木质或长圆形玻璃搅拌棒, 原因如下: ①木质搅拌棒会遗留木屑于银胶内;
3. 未使用完之银胶, 请立即存入冰库. (1 小时之内)
4. 烘烤温度: 150°C/90 分钟
5. 储存温度: -15°C ~ -40°C/6 个月
6. 分装时, 请用开口较宽之存储方便搅拌, 而且分装前需先搅拌均匀. (请不要用装菲林之小罐装, 因为此罐口小, 不易搅拌, 或搅拌不完全.)
7. 搅拌后请立即使用(背胶或点胶)
理由: A. 利用均匀之粘度, 产生紧密的接着力;
B. 不立即使用的话, 银胶之银粉会沉淀.

7. 背胶或点胶后,要在1小时之内接著. 理由: 放置时间太久,银胶外层会先胶化,丧失接著力.
8. 银胶进出冰箱次数不能太多次,以避免影响银胶特性.
9. 烘烤时间过久或温度过高,银胶会焦化,丧失接著力.
10. 烘烤达标后,不能立即开炉取出产品,在急速降温下,会产生裂痕(银胶与脚架或基板)现象,必须在炉内降温至50℃左右才能开炉.

各厂牌烘烤温度比较: 仅供参考用

BRAND	TYPE NO.	STANDARD CURE
SMM	T-3007-20	150℃/90min
AMICON	C-850-6	125℃/60min
ABLEBOND	84-1LMI	150℃/60min
肥特普	FP-5053MV	150℃/60min
上海树脂厂	DAD-87	150℃/4hr

未列出之参数欢迎致电咨询!